



第24期 報告書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

東京エレクトロン デバイス株式会社

証券コード 2760

株主の皆様へ



株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
 当社第24期報告書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
 として事業の概況等をご報告いたします。

代表取締役社長 砂川 俊昭

当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、北米に端を発した前連結会計年度からの金融不安が拡大し、期首において足踏み状態であった景気が、秋頃より急減速する形で推移いたしました。金融危機の深刻化が、企業業績・雇用・消費等の実体経済に影響を及ぼし、世界的な経済危機に対する懸念が深度を増しております。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界におきましては、上半期において、北京オリンピック開催によるデジタル家電の需要拡大が期待されておりましたが、景況感の悪化から総じて低調に推移いたしました。下半期に入り、特に

11月以降においては、未曾有の大不況の影響を受け、デジタル家電をはじめ、パソコン、携帯電話、産業機器等ほぼ全分野で需要が急速に冷え込み、非常に厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は947億1百万円（前期比15.5%減）、営業利益は18億4千万円（前期比50.0%減）、経常利益は20億4千1百万円（前期比47.0%減）となりました。また、当社グループの取引先に対し、特別損失として貸倒引当金繰入額を計上したこと等により、当期純利益は6億1千7百万円（前期比71.8%減）となりました。

経営戦略及び対処すべき課題

① 利益確保に向けた体質強化

- 平成22年3月期におきましては、景気の急速な回復には至らないという見通しを踏まえ、全社的な管理可能費用の大幅な削減に努めてまいります。
- 効率的な営業展開を目指し、かつ、将来の成長を見据えた組織改革を行ってまいります。

② 将来の成長を見据えた成長戦略

- コンピュータシステム関連事業につきましては、事業の業績拡大を図るべく、個々の製品販売中心の営業体制から顧客別営業体制に組織再構築し、より一層顧客に密着した営業展開の推進に努めてまいります。
- 半導体及び電子デバイス事業につきましては、事業再編や

提携等の動きにあわせて商権拡大を図るとともに、新規顧客・新規商品の開拓を推進し、事業の一層の強化に努めてまいります。また、従来の産業機器向けビジネスに加え、今後の成長が見込まれる分野（環境・セキュリティ等）への販売活動にも注力してまいります。

- 開発ビジネスにつきましては、自社ブランドである「inrevium（インレビウム）」の商品開発に引き続き注力するとともに、設計から製造・品質保証までの一貫した物作り体制を確立し、OEMビジネスの強化に努めてまいります。
- 海外事業につきましては、ASEAN地域における顧客サポート体制を充実するとともに、付加価値の高い自社商品のグローバルな販売展開を図ってまいります。

業績ハイライト



(注) 平成18年3月期より連結決算を開始しており、平成18年3月期以降は連結数値を記載しております。

株主還元について

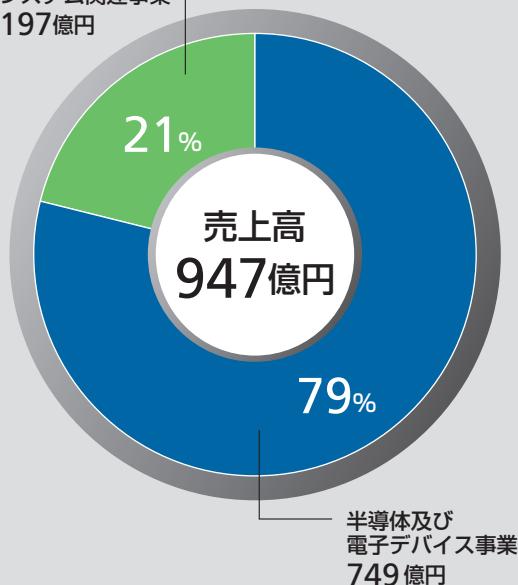
平成21年3月期におきましては、当社を取り巻く環境が非常に厳しいものとなりましたが、継続的かつ安定的な配当実施という基本方針を勘案し、期末配当を3,300円、中間配当3,300円と合わせた年間配当を1株につき6,600円とさせていただきます。なお、次期(平成22年3月期)の配当予想につきましては、1株当たり年間配当金5,000円(中間2,500円・期末2,500円)を予定しております。

	平成21年3月期		平成22年3月期(予想)	
	中間	期末	中間	期末
1株当たり配当金(円)	3,300	3,300	2,500	2,500
配当性向	113.3%		85.5%	

事業紹介

当社グループは、半導体製品、電子部品他の仕入・販売および設計・開発を展開する「半導体及び電子デバイス事業」と、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアをソリューションで提供する「コンピュータシステム関連事業」を展開しております。

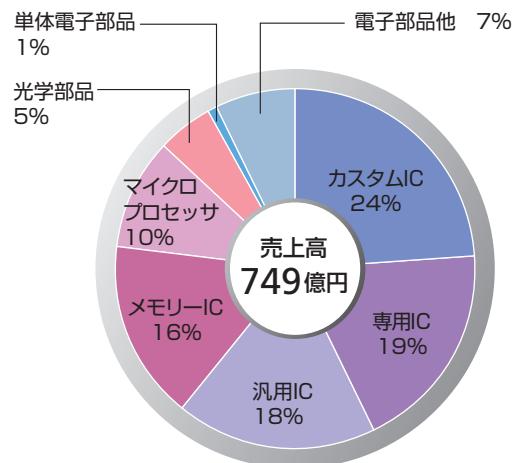
コンピュータ
システム関連事業
197億円



半導体及び電子デバイス事業

79%

品目別売上構成



半導体及び電子デバイス事業では、自社ブランドである「inrevium (インレビウム)」の開発ビジネスおよび重点戦略マーケットである産業機器分野に注力することに加え、国内販売子会社の営業開始や海外事業展開の推進により、顧客に密着した営業展開と新規顧客の開拓に努めてまいりました。

第2四半期（7月～9月）までは携帯電話基地局向けカスタムICやPC向けメモリーICが比較的堅調に推移していたものの、第3四半期（10月～12月）以降は急速な市場環境の悪化により、低調に推移することとなりました。

また、民生機器・産業機器をはじめとした各分野における生産調整等の影響を受け、売上高は749億8千万円、営業利益は7億3千6百万円となりました。



カスタム IC お客様の仕様に応じて作られる固有 IC、ASIC や PLD が代表製品

inrevium

主な商品

- ASIC *1
- PLD *2 (FPGA, CPLD)

主な仕入先 (アルファベット順)

富士通エレクトロニクス(株)、
ザイリンクス社



専用 IC 通信用や画像処理用など、特定用途向けに作られた専用の IC

inrevium

主な商品

- 通信・ネットワーク用 ●画像処理用
- インタフェース用 ●セキュリティ用
- 周辺制御用

主な仕入先 (アルファベット順)

カビウム・ネットワークス社、フリースケール・セミコンダクタ社、
富士通エレクトロニクス(株)、インターシル社、ピクセルワークス社



汎用 IC 色々な用途に共通して使用される IC、アナログ IC やロジック IC など

主な商品

- アナログ IC ●ロジック IC

主な仕入先 (アルファベット順)

リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、
テキサス・インスツルメンツ社



メモリー IC 記憶専用の IC、書き込みと読み出しが可能な RAM、読み出しのみの ROM など

主な商品

- フラッシュメモリー*3 ●DARAM/SRAM
- FRAM

主な仕入先 (アルファベット順)

富士通エレクトロニクス(株)、アイ・ディー・ティー社、
ラムトロンインターナショナル社



マイクロプロセッサ コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能を持つ IC

主な商品

- マイクロプロセッサ ●マイクロコントローラ
- DSP

主な仕入先 (アルファベット順)

フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、
テキサス・インスツルメンツ社



光学部品 電気を光に変換して使用する電子部品

主な商品

- LED*4 ●フォトカプラ*5
- 光ファイバ ●IrDA*6

主な仕入先 (アルファベット順)

アバコ・テクノロジー社、ユーディナデバイス(株)



単体電子部品 増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品

主な商品

- ダイオード*7 ●トランジスタ

主な仕入先 (アルファベット順)

オン・セミコンダクター社



電子部品他 ボード製品や電源・コネクタなど一般電子部品

inrevium

主な商品

- CPU ボード ●インタフェースボード
- 評価ボード ●組み込みボード ●パネル PC
- 電源 ●コネクタ

主な仕入先 (アルファベット順)

コーセル(株)、ダイアロジック社、(株) PFU

*1 [ASIC] 高性能が望めるが、開発期間が長くかかるカスタム IC。

*2 [PLD] プログラム可能な論理素子のカスタム IC。ASIC より短期開発が可能。

*3 [フラッシュメモリー] データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。

*4 [LED] 電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

*5 [フォトカプラ] 電気信号を光に変換して伝達する素子。電氣的な絶縁が利点。

*6 [IrDA] 規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで使用。

*7 [ダイオード] 電流を一方方向のみに流す整流作用を持つ電子部品。

半導体及び電子デバイス事業

開発ビジネス *inrevium*

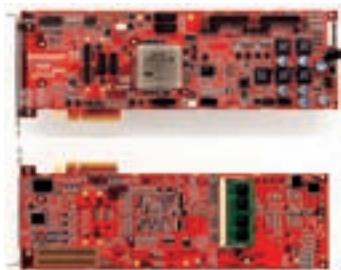
開発ビジネス（自社ブランドビジネス）は、お客様の要求に基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務（デザインサービス）と市場ニーズに沿ったLSIやボード製品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されております。

■ 開発ビジネス売上高推移



■ 自社ブランド商品開発例

当社取扱い商品「ザイリンクス社大規模FPGA (Virtex-5)」を搭載したLSI開発支援用評価ボード。LSI開発の期間短縮、費用削減に効果を発揮。

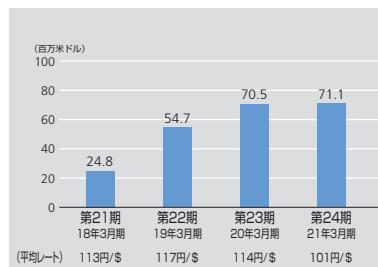


〈主な応用分野〉 計測機器、医療機器などの産業機器用LSI開発ツール

海外ビジネス

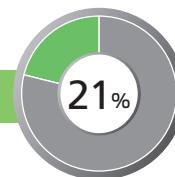
日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開しております。平成17年に東京エレクトロンデバイス香港、平成20年に東京エレクトロンデバイスシンガポールを設立し、上海・大連にも拠点を構え、多言語対応、良質な物流対応に注力しております。

■ 海外ビジネス売上高推移



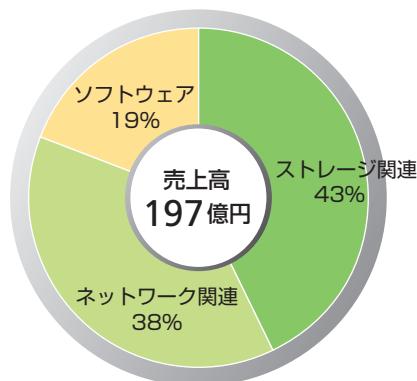
■ 海外営業拠点





コンピュータシステム関連事業

品目別売上構成



コンピュータシステム関連事業では、各企業における内部統制の整備を見据え、コンピュータシステムに関する需要増へ対応するため、コンピュータシステム関連事業の強化に努めてまいりました。しかしながら、企業業績の悪化と景気の先行き不安から、新規のIT投資等、設備投資を抑制する傾向が強まり、売上高は197億2千1百万円、営業利益は11億3百万円となりました。



ストレージ関連 SAN (ストレージ・エリア・ネットワーク) スイッチ、SAN 接続機器、ストレージセキュリティ機器など

主な商品

- SAN ファブリックスイッチ
- バックアップアプライアンス
- テープライブラリ
- ファイバーチャネルホストバスアダプタ
- クラスタ・ストレージ
- データ圧縮アプライアンス

主な仕入先 (アルファベット順)

アコリ社、ブロードコミュニケーションズシステムズ社、データドメイン社、エミュレックス社、アイシロン・システムズ社、クアンタム社、ストアワイズ社、シマンテック社



ネットワーク関連 インターネット接続機器 (負荷分散、セキュリティ)、企業向けネットワークシステム構築機器など

主な商品

- アプリケーショントラフィックマネージャ
- LAN スイッチ
- ファイアウォール
- VPN アプライアンス
- ハードウェアセキュリティモジュール

主な仕入先 (アルファベット順)

エクストリーム・ネットワークス社、F5ネットワークス社、インバーバ社、インフォブロックス社、ジュニパーネットワークス社、エンサイファ社、セキュアコンピューティング社



ソフトウェア 組み込み機器向けの OS やデータ管理を行うデータベースなど

主な商品

- OS
- 開発ツール
- インメモリ・データベース
- 組み込みデータベース・エンジン
- ログ長期保存・分析・ツール

主な仕入先 (アルファベット順)

グリーンプラム社、インターバルゼロ社、マイクロソフト社、オラクル社、フェニックス・テクノロジーズ社、センセージ社

連結財務諸表

連結貸借対照表

資産の部	前 期	当 期
	(平成 20 年 3 月 31 日現在)	(平成 21 年 3 月 31 日現在)
	千円	千円
流動資産	47,005,467	35,854,988
現金及び預金	1,367,624	1,245,602
受取手形及び売掛金	25,633,561	15,479,382
たな卸資産	17,649,887	15,879,470
その他	2,365,852	3,252,091
貸倒引当金	△ 11,458	△ 1,559
固定資産	4,453,012	4,825,237
有形固定資産	1,012,699	1,334,856
無形固定資産	785,538	643,933
投資その他の資産	2,654,774	2,846,446
資産合計	51,458,480	40,680,225

■ 資産

当連結会計年度における総資産は406億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ107億7千8百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、たな卸資産が減少したことによりです。

■ 負債

負債総額は192億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ105億8千6百万円の減少となりました。これは主に、買掛金、短期借入金が減少したことによりです。

負債の部	前 期	当 期
	(平成 20 年 3 月 31 日現在)	(平成 21 年 3 月 31 日現在)
	千円	千円
流動負債	25,584,200	14,482,369
買掛金	13,897,701	6,706,615
短期借入金	6,069,679	3,806,681
その他	5,616,818	3,969,073
固定負債	4,269,405	4,784,484
退職給付引当金	3,859,577	4,304,637
その他	409,828	479,847
負債合計	29,853,605	19,266,854
純資産の部		
株主資本	21,579,799	21,492,916
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	13,438,808	13,351,925
評価・換算差額等	25,074	△ 79,545
純資産合計	21,604,874	21,413,370
負債及び純資産合計	51,458,480	40,680,225

■ 純資産

純資産総額は214億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千1百万円の減少となりました。

連結損益計算書

科 目	前 期	当 期
	(平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)	(平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)
	千円	千円
売上高	112,104,644	94,701,532
売上原価	95,147,030	79,992,053
売上総利益	16,957,614	14,709,479
販売費及び一般管理費	13,278,745	12,869,389
営業利益	3,678,869	1,840,090
営業外収益	428,747	413,161
営業外費用	258,348	212,021
経常利益	3,849,269	2,041,230
特別利益	133	-
特別損失	21,437	746,487
税金等調整前当期純利益	3,827,964	1,294,743
法人税、住民税及び事業税	1,723,550	705,777
法人税等調整額	△ 88,669	△ 28,474
当期純利益	2,193,084	617,440

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前 期	当 期
	(平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)	(平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー	381,751	3,566,916
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,255,951	△ 801,295
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,134,144	△ 2,954,870
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 34,987	124
現金及び現金同等物の増減額	224,956	△ 189,125
現金及び現金同等物の期首残高	1,142,667	1,367,624
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	67,103
現金及び現金同等物の期末残高	1,367,624	1,245,602

(注) 連結財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

次期の見通し

今後の見通しにつきましては、世界的な経済危機に対し、各国において対策が講じられておりますが、依然として景気がさらに下振れる恐れが払拭できない状況が続いております。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界につきましては、これまでの在庫調整が進むことで、一時的には半導体需要の回復が期待されておりますが、エレクトロニクス製品全般の需要自体が弱いことから、中長期的な市況回復の見通しについてはなお不透明感が強く、また、為替の変動等による輸出入への影響も懸念材料とされております。

こうした状況のもと、当社グループでは、組織改編による事業構築の見直しや、外部環境によるマイナス影響を最小限にとどめるようなビジネス体制の強化に取り組み、業績の回復に努めてまいります。

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	37,000 △ 29.4%	360 △ 77.4%	300 △ 80.1%	140 △ 80.9%
通 期	78,000 △ 17.6%	1,450 △ 21.2%	1,300 △ 36.3%	620 0.4%

(注) %表示は前期増減率

株式情報 (平成21年3月31日現在)

株式の状況

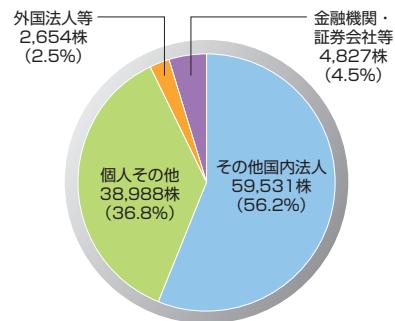
● 発行可能株式総数	256,000 株
● 発行済株式の総数	106,000 株
● 株主数	5,512 名

大株主

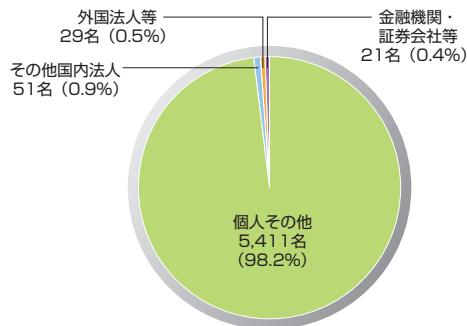
株 主 名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.42
立花証券株式会社	3,709	3.49
東京エレクトロンデバイス社員持株会	3,679	3.47
ノーザン・トラスト・カンパニー・エイブイ・エフシー・リ・ノーザン・トラスト・ガンジー・ノン・トリートイー・クライアントツ	889	0.83
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ	829	0.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	477	0.45

株式分布状況

● 所有者別株式数



● 所有者別株主数



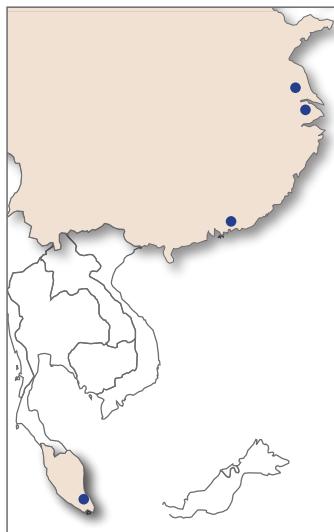
株価と出来高



会社の概要

会社概要 (平成21年3月31日現在)

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	825名(連結)
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア



拠点網

- 本社
- 本社営業部
北関東支社
大阪支社
- 仙台営業所
水戸営業所
松本営業所
浜松営業所
京都営業所
福岡営業所
宇都宮サテライト
厚木サテライト
松山出張所
- 長岡営業所
立川営業所
三島営業所
名古屋営業所
岡山営業所
- CN 新宿オフィス
CN 大阪オフィス
- エンジニアリングセンター
- 上海華桑電子有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス上海)
香港華桑電子有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス香港)
無錫華桑電子科技有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス無錫)
Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd.
(通称: 東京エレクトロンデバイスシンガポール)
パネトロン株式会社

役員等 (平成21年6月17日時点)

取締役

代表取締役社長	砂川 俊昭
取締役	久我 宣之
取締役	木村 勉
取締役	天野 勝之
取締役	徳重 敦之
取締役	東 哲郎
取締役	原 護
取締役	岩田 義文

監査役

常勤監査役	浅野 升徳
監査役	田中 健生
監査役	林田 謙一郎
監査役	川勝 正昭

- (注) 1. 岩田義文氏は、社外取締役であります。
2. 林田謙一郎氏および川勝正昭氏は社外監査役であります。

執行役員

砂川 俊昭
久我 宣之
木村 勉
天野 勝之
徳重 敦之
穴倉 弘明
大崎 正之
八幡 浩司
武井 弘
黒田 修治
山田 信二
林 英樹

個人投資家様向けIR活動

当社は、新聞社や証券会社等が主催するIRフェアや個人投資家説明会に参加しております。

また、当社ホームページ内に個人投資家様向け専用サイトをご用意し、事業内容、業績情報などの配信に努めております。



●日経IRフェア2008
(平成20年8月23日・東京ビッグサイト)



●当社IRサイト：
<http://www.teldevice.co.jp/ir/>

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
(郵便物送付先) 電話照会先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター 0120-78-2031 (フリーダイヤル)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店
公告の方法	電子公告
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第二部 (証券コード 2760)

●上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正により、平成21年1月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。

配当金額取証にてお受取りの株主様は、年末または翌年初に「支払通知書」を送付いたします。

口座振込を指定されている株主様は、配当金支払いの際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。

●株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、**株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合があります**のでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。



電子部品事業にて認証取得

この報告書は再生紙を使用しております。



環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。